

院所系組	電機與資訊學院 電子工程系 碩士在職專班 (建工校區)		
招生分組	電子及資通組	AI 與資安組	醫工組
招生名額	27 名	10 名	2 名
研究領域	光電、半導體、電子電路、類比 IC 設計、軟體設計、數位 IC 設計、FPGA 實作、多媒體訊號處理、人工智慧系統、機器人與嵌入式系統	智慧醫療、智慧製造、人工智慧電腦視覺、自然語言處理、資訊安全防護、網路攻擊分析與偵測	醫學診斷輔助技術、生物資訊處理應用、醫工量測技術開發、生醫穿戴式裝置開發、智慧醫療、生物資訊
甄試項目	書面資料審查 (50%)	1.基本資料表【附表 5】、自傳【附表 6】及學習及研究計畫【附表 7】。 2.大專校院歷年成績單。 3.師長、工作單位主管或所屬職業同業公會線上推薦函兩封。 【線上推薦函注意事項(含操作步驟)請詳簡章第 5-6 頁】 。 4.專業表現及學習潛能與相關特殊表現證明文件：如工作經驗、職務、參與產官學研究計畫、職業證照、專業工作成就、獲獎紀錄、創作、著作、論文發表、推廣教育學習證明及其他足資證明相關潛能之資料。	
	面試 (50%)	1.114 年 3 月 16 日(星期日)於建工校區辦理面試，時程及地點另行公告。 2.符合報考資格考生均可參加面試。	
成績計算	1.總成績=書面資料審查成績×50%+面試成績×50% 2.各甄試項目成績及總成績均四捨五入取至小數點第二位，滿分為 100 分。		
同分參酌順序	1.面試分數。 2.書面資料審查分數。		
特殊報考資格	本系不招收「入學大學同等學力認定標準」第 7 條「專業領域表現具卓越成就者」。		
備註	1.工作年資之規定：需有 1 年(含)以上工作年資。 2.本碩士在職專班分組招生名額得互為流用，若其中一組招生出現缺額情形，該缺額得流用至另一組。 3.上課地點：建工校區。 4.上課時間：週一至週五夜間及週六。 5.113 學年度最低畢業學分數 38 學分，114 學年度依系所規定辦理。		
系所聯絡方式	聯絡人：莊小姐 電話：07-3814526 轉 15601		